

# 2014年度第2回 P&I 研究会シンポジウム

## 「印刷を拓げる新しい塗布技術～超平滑から立体パターンニングまで」

主催 : (社)日本印刷学会 技術委員会 P&I 研究会主催  
協賛 : 高分子学会、日本化学会、応用物理学会、色材協会、日本写真学会、日本画像学会、  
画像電子学会、有機エレクトロニクス材料研究会、フォトポリマー懇話会、日本印刷産業連合会、  
日本印刷産業機械工業会。  
日時 : 2014年10月29日(水) 13:00～18:00(受付開始 12:30)  
会場 : DNP 五反田ビル 〒141-0031 東京都品川区西五反田 3-5-20  
[http://www.dnp.co.jp/about/map/pdf/dnp\\_ope12\\_0607.pdf](http://www.dnp.co.jp/about/map/pdf/dnp_ope12_0607.pdf)

### 開催趣旨

超平滑なコーティング、立体物への成膜など、先端の塗布技術が注目されています。用途展開、特性向上など、印刷の可能性の拓げりをめざして、今回は、「印刷を拓げる新しい塗布技術」と題して、塗布技術の最前線を紹介いただきます。プリンテッドエレクトロニクスに興味のある方、印刷技術の新しい展開に期待される方、材料メーカー、計測器メーカーの方、プロセス・装置を扱っている方、もしこんなことができたなら…という用途・応用をお持ちの方に、ぜひご参加いただき、今後の可能性を議論いただきたいと思います。

### プログラム

- 13:00～13:50 原子堆積法による3次元光触媒の応用  
原子レベルでの超平滑コーティングとその応用についてお話しいたします  
大阪大学 レーザーエネルギー学研究中心 實野 孝久
  - 13:50～14:40 水分散有機半導体コロイドインクの開発  
静電塗工の最新技術として、有機半導体をコロイド粒子として水中に分散させ、塗布プロセスに適用可能な環境調和型機能性インク実現の例をお話しいたします。  
FLOX(株)和光テクニカルセンター 松鷹 宏
  - 14:40～15:30 塗布基材の表面物性の解析  
湿式塗布の基礎となる基材表面の特性について、分子構造、形状、機械強度面に着目した多面的解析手法によるアプローチについてお話しいたします  
大日本印刷(株)研究開発センター 西園 健史
- 休憩-----
- 15:50～16:40 インクジェット加飾技術の立体物へのチャレンジ  
進化するインクジェット技術の中で、立体物への最新のカラー画像形成技術を紹介いただきます。  
(株)ミマキエンジニアリング 技術本部 大西 勝
  - 16:40～17:30 筐体ダイレクト印刷配線技術  
エレクトロニクスデバイスの筐体にダイレクト印刷を可能とする 低温焼成可能な低抵抗インクおよび立体面へのダイレクト印刷配線についてお話しいたします。  
トッパン・フォームズ(株) 中央研究所 名和 成明

定員 : 70名  
参加費 : 会員・協賛団体会員7,000円、教職員・シニア2,000円、学生1,000円、非会員9,000円  
申込先 : (一社)日本印刷学会 〒104-0032 東京都中央区新富1丁目16-8  
E-Mail: [nijspst-h@attglobal.net](mailto:nijspst-h@attglobal.net) FAX: 03-3552-7206 TEL: 03-3551-1808  
申込方法 : 日本印刷学会のホームページ<http://www.jspst.org/>からの参加登録をお願いします。  
セミナー・講座・シンポジウムから本シンポジウムを選択してお申し込みください。  
E-Mailまたはファックスでも結構です(氏名、所属、連絡先、会員の有無を記入ください)。  
支払いは当日受付でお願い致します。定員がありますので、お早めにお申し込みください。  
お断り : 事情によりプログラムまたは講師を変更する場合があります。